

トレックス・セミコンダクター株式会社  
品質保証部

## 成分表

製品名(鉛フリー): XP161A1355PR-G  
標準質量: 53 mg

名称	質量(mg)	物質名称	構成比率(ppm)	CAS No.
シリコンチップ	1.272	シリコン	24000	7440-21-3
		- 砒素	<1	7440-38-2
リードフレーム	24.392	銅	460200	7440-50-8
		錫	300	7440-31-5
		銀	4100	7440-22-4
ダイアタッチ	0.115	銀	2200	7440-22-4
		エポキシ	600	—
		無機化合物	200	—
		三酸化アンチモン	100	1309-64-4
ボンディングワイヤ	0.236	金	4500	7440-57-5
封止樹脂	21.312	溶融シリカ	402100	60676-86-0
		エポキシ樹脂	36400	—
		フェノール樹脂	30200	—
		金属水酸化物	27600	—
端子メッキ	0.400	錫	7500	7440-31-5

※ 成分組成は、ベンダーからの情報を元に算出しております。機密情報保持の為、  
開示されない情報があり、全内容を保証するものではありません。

※ 質量、構成比率については、材料等の製造条件によって異なることがあります。

※ CASNo.欄で「-」と表記された物質は、社外秘とさせていただきます。